

北京耐威科技股份有限公司

关于为全资子公司申请委托贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为继续推进8英寸MEMS国际代工线建设项目的建设，公司全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）拟向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向瑞通芯源发放该笔贷款，贷款期限为12个月，利率为6.5%。现公司拟为瑞通芯源此次申请委托贷款提供连带责任担保。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110302339754151E
- 2、名称：北京瑞通芯源半导体科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼6层601-5室
- 5、法定代表人：杨云春
- 6、注册资本：50,000万元

7、成立日期：2015年04月28日

8、营业期限：2005 年 04 月 28 日至 2045 年 04 月 27 日

9、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞通芯源为公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日(未经审计)	2016 年 12 月 31 日
资产总计	82,536.13	65,934.12
负债总计	23,929.54	12,815.79
所有者权益	58,606.59	53,118.32
项目	2017 年 1-6 月（未经审计）	2016 年度
营业收入	15,650.72	27,179.77
营业利润	1,899.88	1,730.51
净利润	1,418.51	1,447.63

三、担保的主要内容

根据公司发展需要，公司全资子公司瑞通芯源拟向亦庄国投申请人民币 7 亿元的委托贷款，由亦庄国投委托建设银行向瑞通芯源发放该笔贷款，用于投入 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目。

现公司为瑞通芯源此次申请的人民币 7 亿元、为期 12 个月的委托贷款提供连带责任担保，最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准，瑞通芯源免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：瑞通芯源此次向亦庄国投申请人民币 7 亿元的委托贷款，有利于顺利推进 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目。公司本次担保有利于瑞通芯源筹措资金，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意公司为瑞通芯源此次申请委托贷款事项提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额
2014年6月10日	公司	耐威时代	最高额抵押担保	3,500.00
2017年7月18日	公司	耐威时代	项目贷款连带责任担保	3,000.00
2017年9月25日	公司	瑞通芯源	委托贷款连带责任担保	70,000.00
2017年9月25日	公司	瑞通芯源	银行授信连带责任担保	2,000.00
2017年9月25日	耐威时代	公司	银行授信连带责任担保	10,000.00
合计	-	-	-	88,500.00

截至本公告日，公司仅存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为88,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的62.82%，占公司最近一期经审计总资产的49.83%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年9月25日